

## 綠色政策

## 富士通半導體的環境友善型

## 超級綠色產品 Part 3

下面是接上期內容，繼續介紹富士通半導體集團產品中，獲得 2009 年度超級綠色認定、特別優秀的環保產品。

## 應用於 WiMAX 模組的電源晶片

## MB39C316

## 為 WiMAX 模組的低功耗和小型化做出貢獻！

該產品可與上期介紹的 Mobile WiMAX 基帶晶片“MB86K22/MB86K23”及射頻晶片共同構成品片組，內建于小型 WiMAX 通信模組中。

以往需要多個電源晶片實現的電壓控制只需單一晶片即可實現，為搭載該晶片產品的小型化做出了貢獻。此外，外接元器件數量的減少，還可簡化複雜的電源周邊設計，有利於縮短開發週期。

[http://jp.fujitsu.com/microelectronics/products/assp/power/index\\_p4.html](http://jp.fujitsu.com/microelectronics/products/assp/power/index_p4.html)

## 環境要素

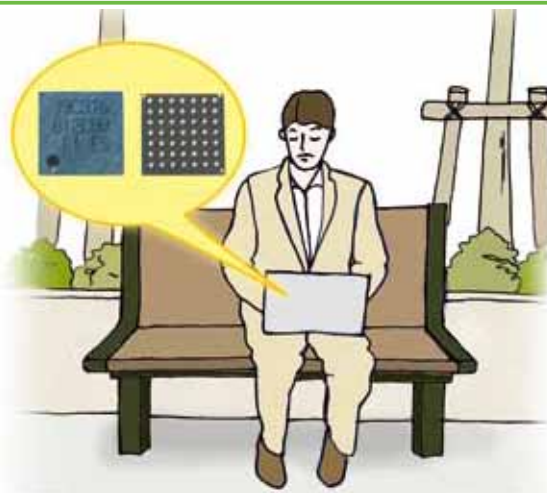
Point 1 節能

Point 2 3R 設計與技術（集成度高、節省資源）

## 環保效果

Point 1 節能：與以往產品相比待機時電源部分的電流消耗降低 15%

Point 2 3R 設計：與以往產品相比封裝尺寸減少 20%



## 面向 3G 手機集電源與音訊功能于一體的晶片

## MB39C311A、MB39C311B、MB39C322

## 實現手機的低功耗與小型化！

隨著手機的多功能化和小型化需求，手機搭載的元器件的封裝體積需要進一步減小。

該產品將 3G 手機的電源功能和音訊功能集成于單一晶片，縮小了封裝尺寸，為手機的小型化和薄型化做出了貢獻；與當前 3G 手機所使用的音訊晶片相比，播放音樂時音訊部分的電流消耗降低一半，同時也為手機的低功耗做出了貢獻。

[http://jp.fujitsu.com/microelectronics/products/assp/power/index\\_p3.html](http://jp.fujitsu.com/microelectronics/products/assp/power/index_p3.html)

## 環境要素

Point 1 節能

Point 2 3R 設計與技術（集成度高、節省資源）

## 環保效果

Point 1 節能：播放音樂時音訊功能部分的電流消耗減少一半

Point 2 3R 設計：與以往產品相比封裝尺寸減少 20%

